

4.5 mm行程(双响键型)

具有平滑且线性操作感。



产品一览

外形图

Unit:mm

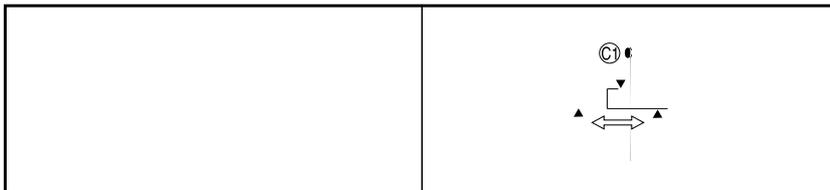
No.	形状	印刷电路板安装孔尺寸图(自A方向看)
1		

外形图

Unit:mm

No.	形状
2	<p>The drawing includes three views: a top view showing a square footprint with dimensions 16.8mm by 14mm and a central hole of diameter 6.1mm; a side view showing a total height of 17.2mm, with sub-dimensions of 9.5mm, 1.2mm, 8.8mm, and 4.5mm, and diameters of $\phi 11.15$, $\phi 9.7$, and $\phi 10$; and a detail view of the terminal block with diameters $\phi 4.8$ and $\phi 10$, and a height of 6.75mm. Labels include '切换位置' (switch position), '行程' (stroke), and 'Terminal No. ①', 'Terminal No. ②', and 'Terminal No. ③ ④'.</p>

电路图



注

发货时的接点位置,可为 , 的任何一个。

检测

滑动

按动

旋转

电源

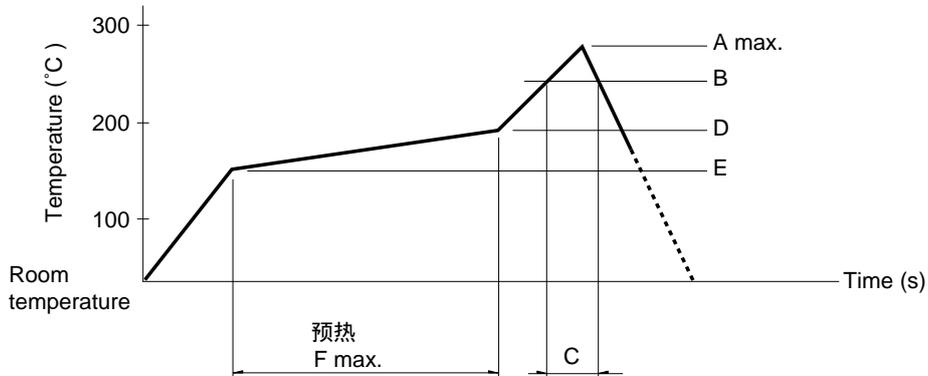
切换式

卧式

立式

回流方式的参考举例

1. 加热方式 远红外线加热的上下加热方式。
2. 温度测量方式用 τ 0.1 ~ τ 0.2的CA (K) 或CC (T) 进行测量。在焊接的连接部位置 (铜箔面) 测量, 固定方式使用耐热载带。
3. 温度分布



系列 (回流型)	A () 3s max.	B ()	C (s)	D ()	E ()	F (s)
SPEJ	260	230	40	180	150	120
SPEF						
SPEH						

注

1. 上述条件, 为印刷电路板的零部件贴装面上的温度。根据电路板的材质、大小、厚度等, 回路板温度和开关表面温度会有很大的不同, 关于开关表面温度, 也请在上述条件内使用。
2. 根据回流槽的种类, 条件稍有不同, 请事先充分进行确认之后使用。

手工焊接方式的参考举例

系列	焊接温度	焊接时间
SPPJ3, SPPJ2, SPUN, SPPH4, SPPH1	350±10	3+1 / 0s
SPED2, SPED4	350±10	3±0.5s
SPEJ	350±10	4s max.
SPEF	350±5	3s max.
SPEH	350 max.	3s max.
SPUJ	300±10	3+1 / 0s

浸焊方式的参考举例

适用于 For PC board 端子型

系列	项目		浸焊	
	预热温度	预热温度时间	焊接温度	焊接浸渍时间
SPPJ3	100 max.	60s max.	260±5	5±1s
SPUN	100 max.	60s max.	260±5	10±1s
SPUJ, SPPH4	—	—	260±5	5±1s
SPPJ2, SPPH1, SPED2, SPED4, SPEF	—	—	260±5	10±1s